

平成25年度

第3回プリントドエレクトロニクスシンポジウム

(FLEC、JAPER、次世代プリントドエレクトロニクスコンソーシアムの共同開催)

～ プリントドエレクトロニクスの産業化に向けた材料・製造技術の多様な展開 ～

【開催概要】

印刷法によって電子回路・デバイスを製造する“プリントドエレクトロニクス”技術は、省資源、省エネルギー、短タクト化、等によるイノベーションへの期待から、材料、プロセスからデバイス、システムに亘って多岐にわたる研究開発の取り組みが進行しています。今回のシンポジウムでは、プリントドエレクトロニクス技術の更なる展開をけん引する「半導体材料」および「3D製造技術」の開発における第一人者の先生をお招きして現在の立ち位置と今後の展望について議論する場を企画しました。皆様におかれては、企業・研究機関・大学が一同に会する場として企画いたしましたので、国内の技術者・研究者との交流を深め、技術インテグレーションを加速するための場として是非ご活用ください。なお本シンポジウムは、産総研フレキシブルエレクトロニクス研究センター（FLEC）、次世代プリントドエレクトロニクス技術研究組合（JAPER）、および次世代プリントドエレクトロニクスコンソーシアムの共同開催による企画です。

【日時】 2013年12月10日(火)9:55～17:00

【会場】 秋葉原コンベンションホール
(JR秋葉原駅より徒歩1分、秋葉原ダイビル2階、<http://www.akibahall.jp/>)

【当日受付】 9:30頃から開始の予定です。受付にてご名刺を頂戴いたします。

【参加費】 無料

【プログラム】（時間は講演準備ならびに質疑応答を含みます。）

9：55 開会あいさつ 一村 信吾 産総研副理事長

● セッション1

10：00－10：05 【半導体材料】イントロダクトリー・トーク

長谷川 達生 (産総研 FLEC)

10：05－10：45 ① 招待講演(40分)「プリンテッドエレクトロニクス用有機半導体の実用化に向けてープロセス技術と材料設計ー」

半那 純一 様 (東京工業大)

10：45－11：00 ② 一般講演(15分)「インクジェット印刷による有機半導体単結晶薄膜の作製」

峯廻 洋美 (産総研 FLEC)

11：00－11：40 ③ 招待講演(40分)「印刷・フレキシブル技術からみた酸化物半導体の現状と課題」

神谷 利夫 様 (東京工業大)

11：40－13：00 昼食

● セッション2

13：00－13：40 ④ 招待講演(40分)「カーボンナノチューブー電子機能と構造制御ー」

遠藤 守信 様 (信州大)

13：40－13：45 【3D製造技術】イントロダクトリー・トーク

牛島 洋史 (産総研 FLEC)

13：45－14：25 ⑤ 招待講演(40分)「動きながら測定可能なMEMSレーザ高感度非侵襲的血流量センサ」

澤田 廉士 様 (九州大)

14：25－14：55 ⑥ 依頼講演(30分)「3D積層造形技術による金属部品の製造」

中野 禅 様 (産総研)

14：55－15：10 ⑦ 一般講演(15分)「三次元デバイス製造技術としての印刷技術」

吉田 学 (産総研 FLEC)

15：10－15：30 コーヒーブレイク

● セッション3

- 15 : 30 - 16 : 00 ⑧ 依頼講演(30分)「3D電子実装技術の開発動向とプリント
ドエレクトロニクスへの応用展開の期待」
青柳 昌宏 様 (産総研)
- 16 : 00 - 16 : 15 ⑨ 一般講演(15分)「印刷デバイス実装技術ースクリーンオフセ
ット印刷法、フレキシブルコネクタ、フレキシブル近接センサ」
野村 健一 (産総研 FLEC)
- 16 : 15 - 16 : 30 ⑩ 一般講演(15分)「プリントドエレクトロニクス/海外動向」
氏家 孝二 (JAPER A)
- 16 : 30 - 16 : 45 ⑪ 一般講演(15分)「国内外におけるプリントドエレクトロニ
クス周辺の特許動向」
本田 卓 (JAPER A)
- 16 : 45 - 17 : 00 ⑫ 一般講演(15分)「国際標準化に向けたアクション」
小笹 健仁 (産総研 FLEC)
- 17 : 00 閉会あいさつ 鎌田俊英 産総研 FLEC センター長